

Um Anmeldung wird bis zum 28. Juni 2012 gebeten.
Michael Scherer · scherer@tsb-berlin.de · Fax: +49 30 46302444
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Am Forschungspolitischen Dialog „Intelligente Oberflächen“
am 5. Juli 2012 · 8.30 – 15.30 Uhr im Heizkraftwerk Moabit
Friedrich-Krause-Ufer 10 – 15 · 13353 Berlin

- nehme ich teil
 kann ich leider nicht teilnehmen

Firma/Institution

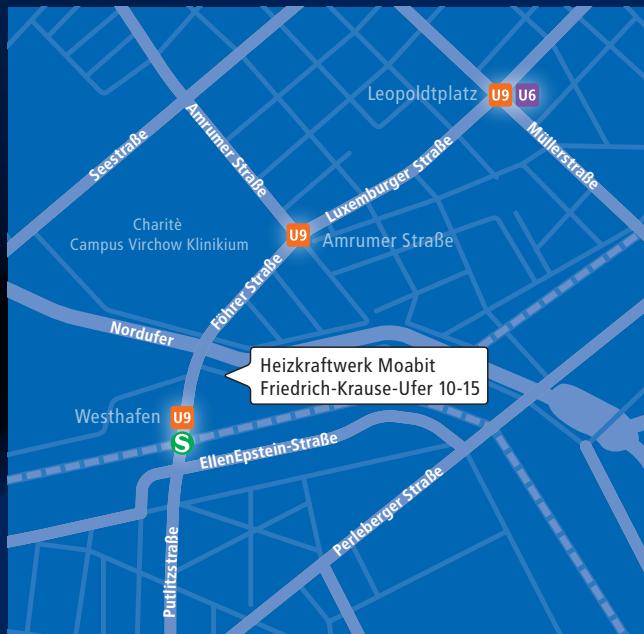
Titel, Name, Vorname

Straße

Ort

E-Mail

Kontakt und Anfahrt



TSB Technologiestiftung Berlin
Annette Kleffel
Fasanenstraße 85 · 10623 Berlin
Telefon +49 30 46302 502
kleffel@tsb-berlin.de
www.tsb-berlin.de

Eine Veranstaltungsreihe der TSB Technologiestiftung Berlin und der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung

Forschungspolitischer Dialog
Persönliche Einladung

Intelligente Oberflächen

Donnerstag, 5. Juli 2012 · 8.30 – 15.30 Uhr
Heizkraftwerk Moabit
Friedrich-Krause-Ufer 10 – 15 · 13353 Berlin



Dieses Vorhaben der TSB Technologiestiftung Berlin wird aus Mitteln des Landes Berlin und der Investitionsbank Berlin gefördert, kofinanziert von der Europäischen Union – Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung. Investition in Ihre Zukunft

Der Forschungspolitische Dialog wurde 1995 von der Senatsverwaltung für Forschung, der TSB Technologiestiftung Berlin und dem Veranstaltungsort der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH Berlin initiiert.

TSB 
TECHNOLOGIESTIFTUNG BERLIN

Forschungspolitischer Dialog

Intelligente Oberflächen

8.30 Registrierung und Kaffee**9.00 Begrüßung**

- Norbert Quinkert TSB Technologiestiftung Berlin

9.05 Grußwort

- Staatssekretär Nicolas Zimmer Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung

9.15 Vorstellung der TSB Studie

Intelligente Oberflächen – Innovationen aus Wissenschaft und Wirtschaft in Berlin-Brandenburg

- Ines Junge TSB Technologiestiftung Berlin

9.40 Podiumsdiskussion

Einbindung von Querschnittstechnologien in die gemeinsame Innovationsstrategie Berlin und Brandenburg

- Staatssekretär Nicolas Zimmer Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung
- Staatssekretär Henning Heidemanns Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg
- Prof. Dr. Dieter Hofmann Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP
- Prof. Dr. Günther Tränkle Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH)
- Moderation: Dr. Adolf M. Kopp
TSB Innovationsagentur Berlin GmbH

10.30 Pause**11.15 Themenblock 1**

Dünnenschichttechnologie

- Dr. Friedhelm Heinrich Technische Hochschule Wildau, AG für Photonik, Laser- und Plasmatechnologien
- Prof. Dr. Jürgen P. Rabe Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Physik
- Peter Krause First Sensor AG
- Dr. Olga Kulikovska Bundesdruckerei GmbH
- Moderation: Prof. Dr. Günther Tränkle Ferdinand-Braun-Institut Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH)

12.15 Themenblock 2

Biologisierung und Biofunktionalisierung

- Dr. Joachim Storsberg Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP
- Dipl.-Ing. Susanne Kahl Merete Medical GmbH
- Prof. Dr. Marga C. Lensen Technische Universität Berlin, Institut für Chemie
- Dr. Wilfried Weigel Scionion AG
- Dr. Karl Kratz Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Zentrum für Biomaterialentwicklung Teltow
- Moderation: Dr. Helmut Kunze
TSB Innovationsagentur Berlin GmbH

Mittagspause**14.15 Themenblock 3**

Bauteile & Beschichtung

- Dr. Driss Bartout Technische Universität Berlin, Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb – Füge- und Beschichtungstechnik
- Dipl.-Ing. Wagdi Garkas Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Lehrstuhl Metallkunde und Werkstofftechnik
- Dr. Rolf Wilkenhöner Siemens Energy/Turbine Airfoil Coating and Repair (angefragt)
- Dr. Peter Siemroth Arc Precision GmbH
- Moderation: Dr. Sascha Peters
HAUTE INNOVATION – Agentur für Material und Technologie

15.15 Abschluss

- Dr. Christian Hammel TSB Technologiestiftung Berlin

Der Forschungspolitische Dialog

analysiert Stärken und Schwächen der Region und zeigt die Leistungsfähigkeit und Attraktivität des Standortes für innovative Technologien auf. Die Teilnehmer diskutieren geeignete Unterstützungs- und Vernetzungsmaßnahmen.